

# 2025年度 第4四半期 決算説明資料

2026.4.22

## 将来の見通しに関する注意事項

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与える重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

売上高

4,368 億円

前年 3,933 億円

過去最高

GP率

70.1 %

前年 70.6%

営業利益

1,849 億円

前年 1,668 億円

過去最高

利益率

42.3 %

前年 42.4 %

CAPEX

327 億円

前年 698 億円

R&D

341 億円

前年 316 億円

総資産

7,434 億円

前年 6,540 億円

4年累計経常利益率

41.4 %

前年 40.0 %

FCF

-22 億円

前年 523 億円

ROE

25.1 %

前年 27.6 %

EPS

1,249.84 円

前年 1,143.26 円

過去最高

年間配当

1株当たり

505 円

前年 413 円

過去最高

(単位：百万円)	FY2025 4Q
売上高	133,060
売上総利益	94,402
GP率	70.9%
販売管理費	35,625
営業利益	58,777
経常利益	58,484
経常利益率	44.0%
税前利益	58,437
純利益	42,881

FY2025 3Q	QoQ	
	差額	(%)
109,291	23,770	21.7%
78,064	16,338	20.9%
71.4%	-0.5p	-
30,723	4,902	16.0%
47,340	11,436	24.2%
46,985	11,499	24.5%
43.0%	1.0p	-
46,801	11,636	24.9%
36,726	6,155	16.8%

FY2024 4Q	YoY	
	差額	(%)
120,716	12,344	10.2%
84,218	10,184	12.1%
69.8%	1.1p	-
32,482	3,142	9.7%
51,735	7,042	13.6%
51,863	6,621	12.8%
43.0%	1.0p	-
51,504	6,933	13.5%
38,638	4,243	11.0%

売上高： YoY 機械装置の検収進捗および消耗品出荷堅調により増収  
 GP率： YoY 高付加価値製品の貢献および為替影響により収益性向上  
 販売管理費： YoY 人件費や研究開発費が増加

(単位：百万円)	FY2025 Full Year	FY2024 Full Year	YoY	
			差額	(%)
売上高	436,889	393,313	43,576	11.1%
売上総利益	306,477	277,570	28,907	10.4%
GP率	70.1%	70.6%	-0.5p	-
販売管理費	121,487	110,736	10,751	9.7%
営業利益	184,989	166,834	18,156	10.9%
経常利益	184,936	168,943	15,993	9.5%
経常利益率	42.3%	43.0%	-0.7p	-
税 前 利 益	183,811	168,146	15,665	9.3%
純 利 益	135,521	123,891	11,630	9.4%

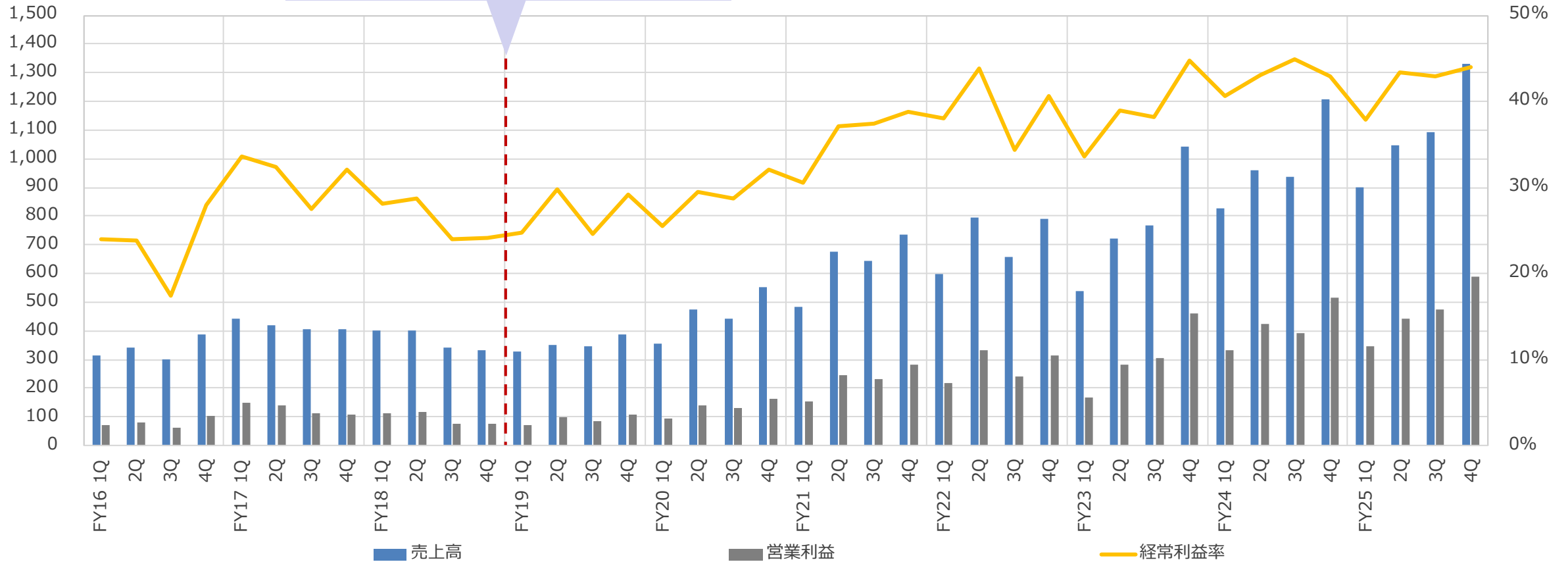
売上高： 生成A I向けを中心に装置の出荷増・検収進捗により増収

GP率： 製品・用途構成の変化で僅かに低下も高水準を記録

販売管理費： 人件費や研究開発費を中心に増加

会計方針変更により  
収益認識のタイミングを検収時に変更

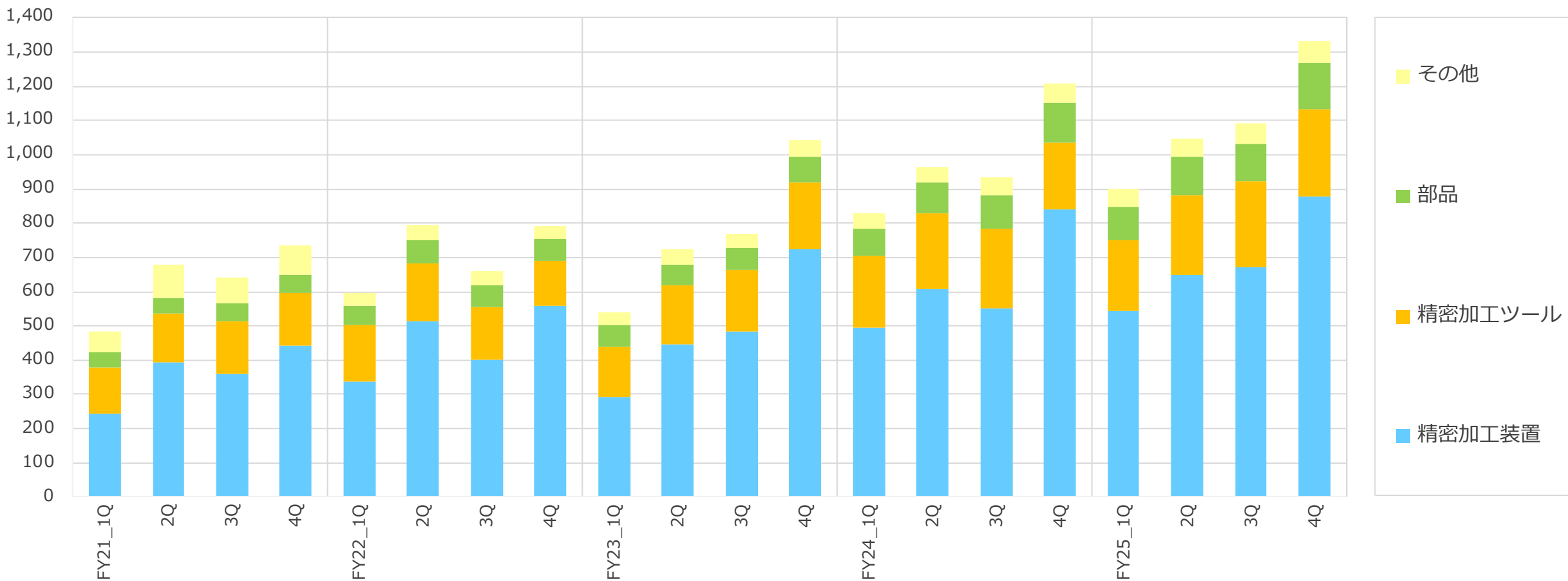
(単位：億円)



FY25\_4Q 営業利益率44.2% 経常利益率44.0% 純利益率32.2%  
※数値推移は、Webサイト「補足情報」に記載

# 製品群別売上高 四半期推移

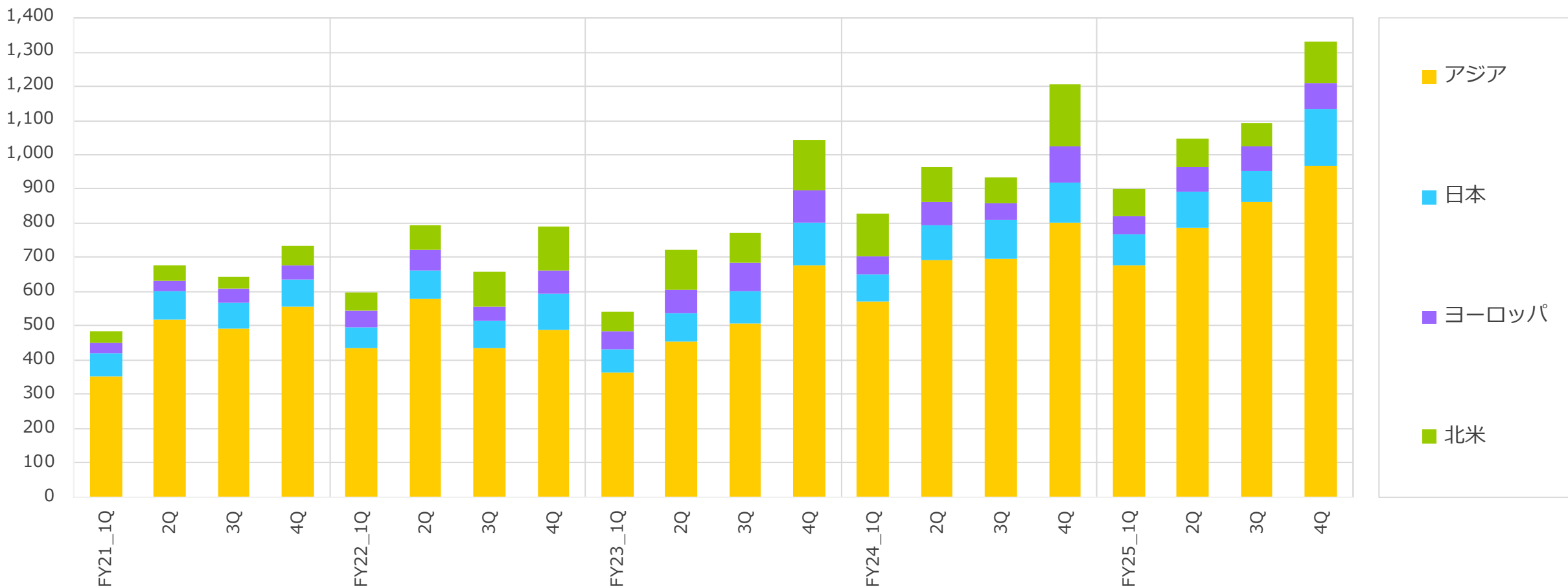
(単位：億円)



※構成比数値は、Webサイト「補足情報」に記載

# 地域別売上高 四半期推移

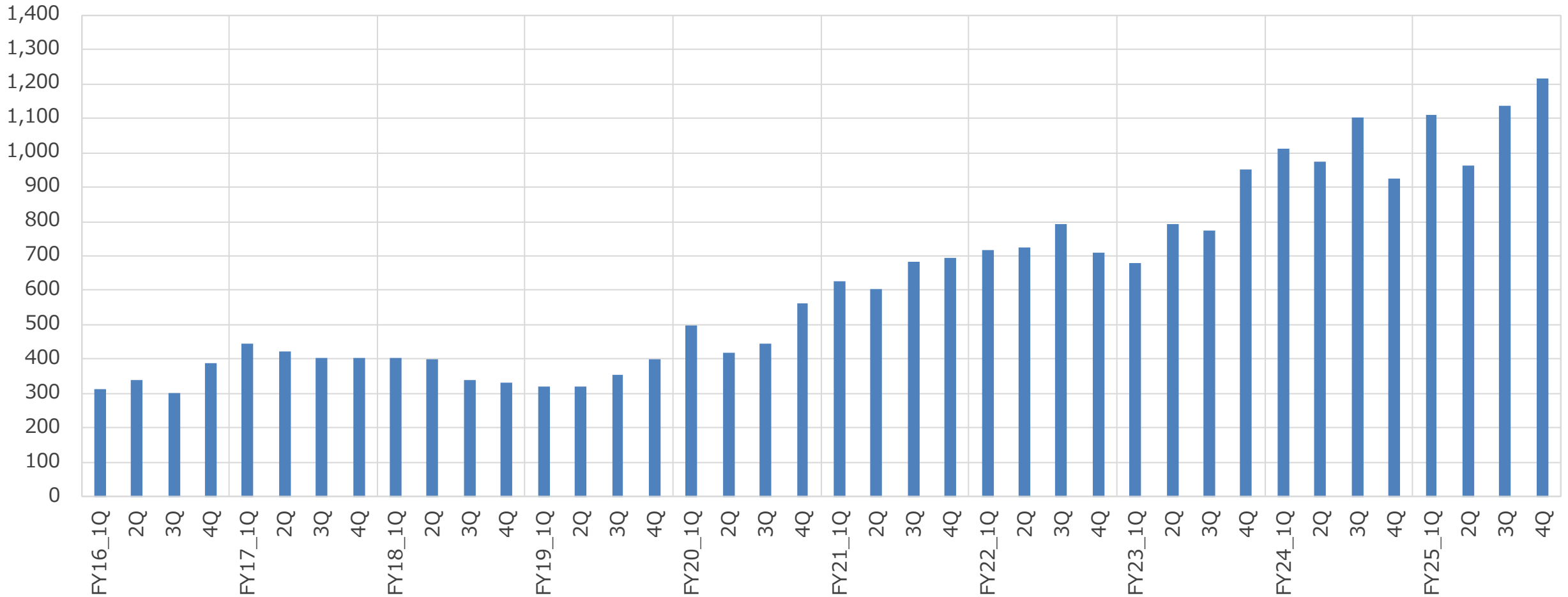
(単位：億円)



FY25\_4Q 海外売上高比率 87.6%

# 出荷額推移

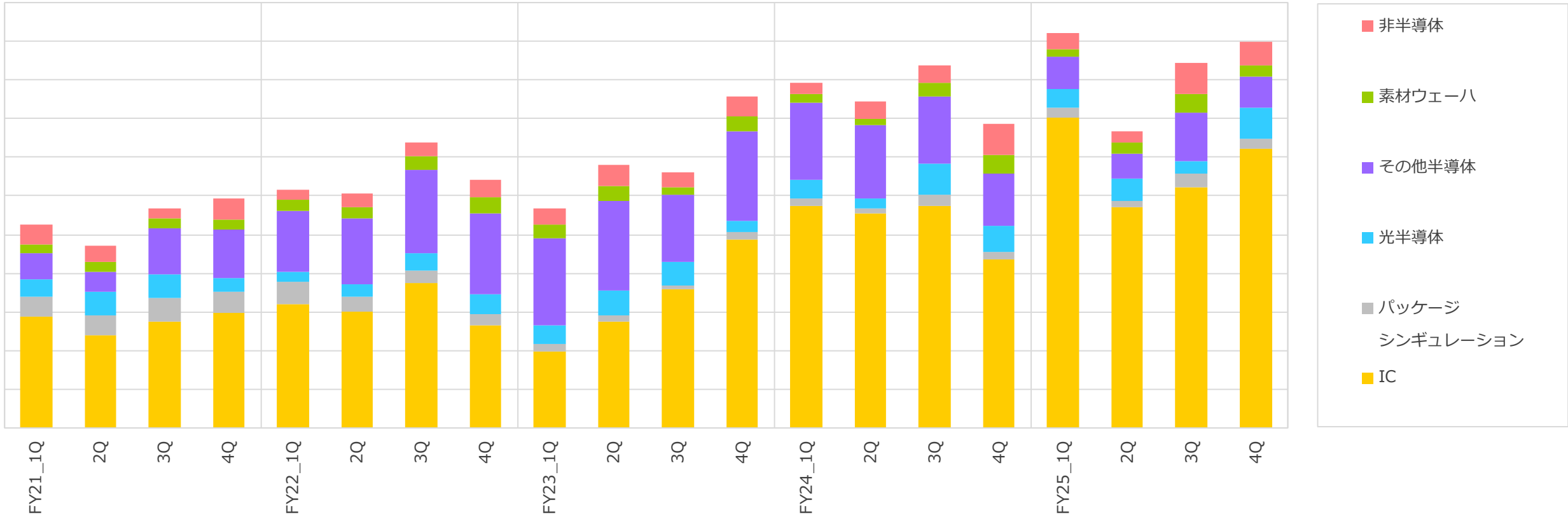
(単位：億円)



FY25\_4Q 出荷額 1,216億円 (過去最高)

出荷額ベース

精密加工装置

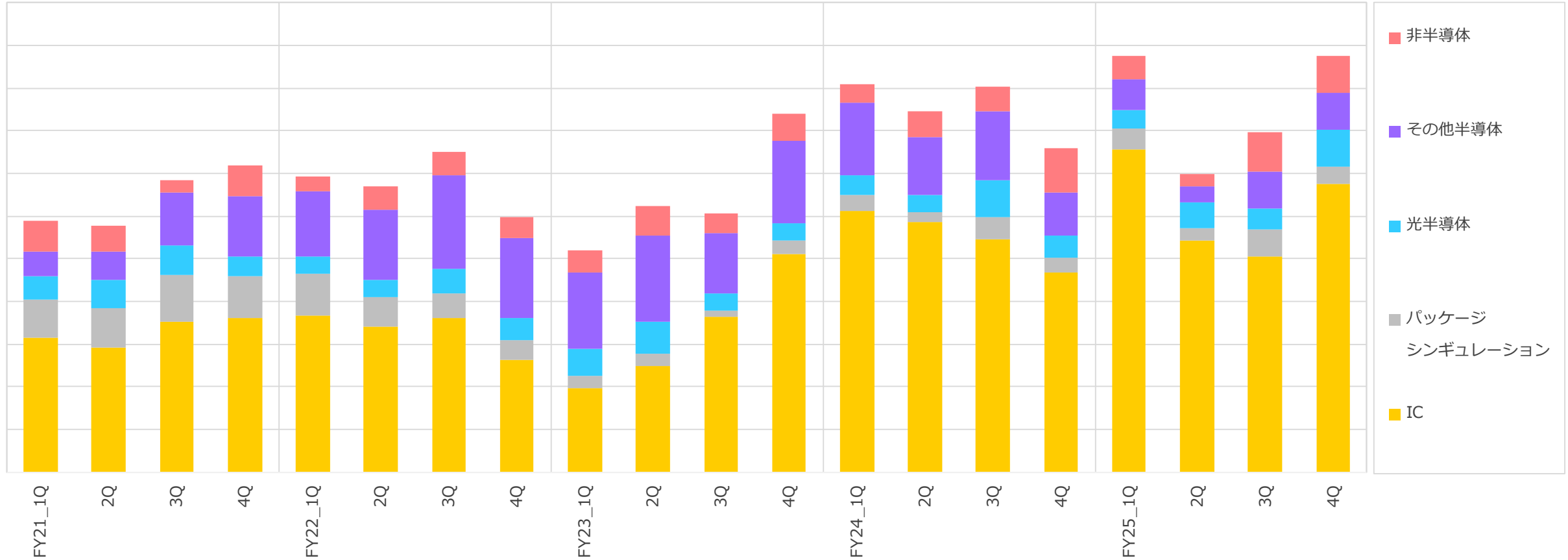


QoQ  
YoY

生成AI向けを中心に、IC向けの増加が全体を押し上げた  
旺盛な生成AI需要を背景にIC向けが伸長

出荷額ベース

ダイサ

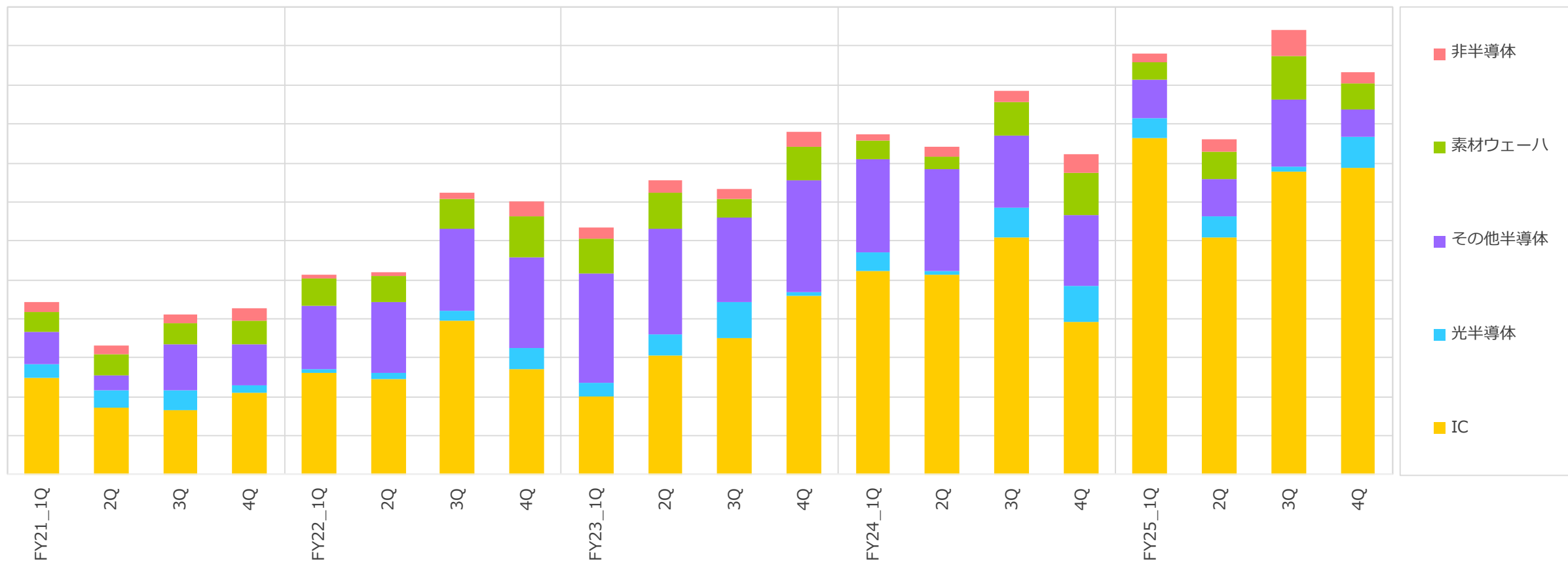


QoQ  
YoY

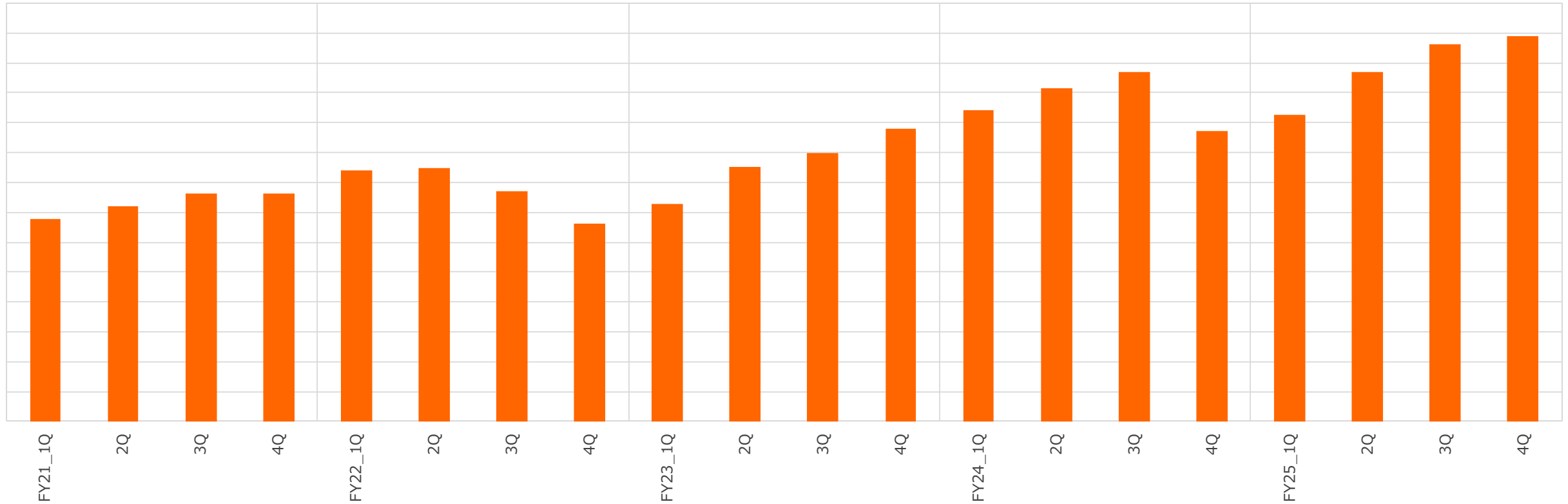
生成AIおよびOSAT向けを中心にIC向けが増加  
 その他半導体（主にパワー半導体）向けが減少するもIC向けが増加

出荷額ベース

グラインダ



QoQ IC向けは堅調に推移するも、その他半導体（主にパワー半導体）向けが減少  
 YoY その他半導体（主にパワー半導体）向けが減少するもIC向けが増加



顧客の設備稼働率等を背景に前四半期から増加し過去最高を更新

(単位：百万円)	FY2025 4Q	FY2025 3Q	差額
現金及び預金	284,575	246,143	38,432
受取手形・売掛金	57,477	50,761	6,717
棚卸資産	141,325	141,596	-271
流動資産	494,572	446,956	47,616
有形固定資産	223,241	211,567	11,673
固定資産	248,838	231,307	17,531
総資産	743,410	678,263	65,147
流動負債	154,458	134,719	19,739
固定負債	826	932	-106
負債合計	155,285	135,652	19,634
純資産	588,125	542,611	45,514
負債純資産合計	743,410	678,263	65,147
自己資本比率	78.9%	79.8%	-0.9p

総資産：主に現預金や有形固定資産が増加

負債：主に賞与引当金や未払法人税が増加

純資産：主に利益剰余金が増加

(単位：百万円)	FY2025 Full Year	FY2024 Full Year	差額
営業キャッシュ・フロー	133,543	120,364	13,179
税前当期利益	183,811	168,146	15,665
減価償却	14,821	12,198	2,623
売上債権の増減	-11,009	2,874	-13,883
棚卸資産の増減	-207	-24,596	24,389
仕入債務の増減	-10,694	-4,795	-5,899
法人税支払い	-55,110	-37,738	-17,372
その他営業CF	11,931	4,276	7,656
投資キャッシュ・フロー	-135,769	-68,002	-67,766
有形固定資産の取得	-35,143	-66,861	31,718
その他投資CF	-100,625	-1,141	-99,484
フリー・キャッシュ・フロー	-2,225	52,362	-54,587
財務キャッシュ・フロー	-45,035	-38,150	-6,885
配当金支払い	-45,309	-38,467	-6,842
現金同等物増減	-44,591	13,680	-58,272
期首残高	229,167	215,486	13,681
期末残高	184,575	229,167	-44,591

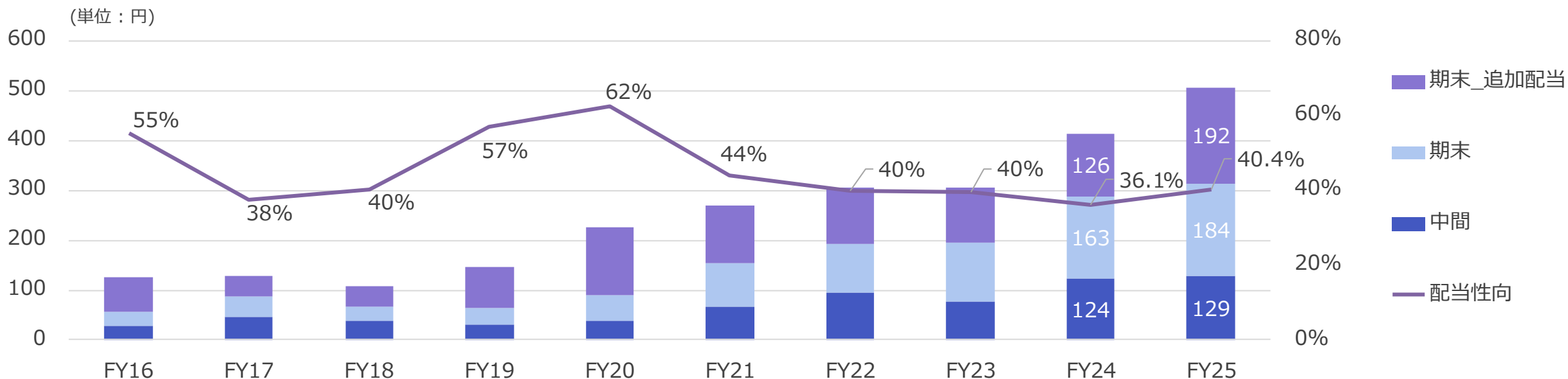
- 営業CF・・・約1,335億円 資金増加  
主に税前利益による資金増加
- 投資CF・・・約1,357億円 資金減少  
有形固定資産の取得および  
定期預金での支出（1,000億円）が発生
- フリー・キャッシュ・フロー  
約22億円の資金減少
- 財務CF・・・約450億円 資金減少  
主に配当金の支払い
- 3月末の現金残高 約1,845億円

補足：  
BS上の現金預金の残高 約2,845億円  
追加配当に関わる余剰資金は、BS上の「現金  
及び預金」の残高を踏まえて計算

## 【配当方針】

1. 期末、中間の年2回、連結半期純利益の25%を配当する
2. 安定配当として半期10円（年間20円）を維持。ただし3期連続で連結純損失の場合を除く
3. 年度末時点で赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額(\*)を超過した場合は、上記1.に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乗せする（追加配当）

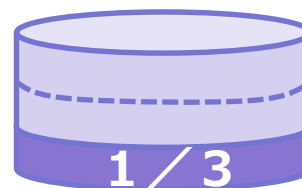
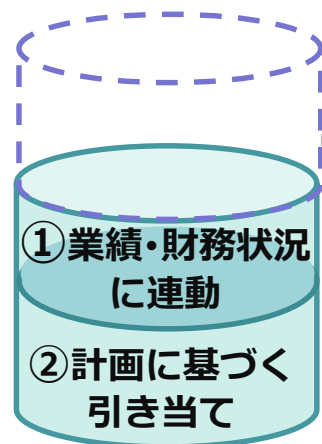
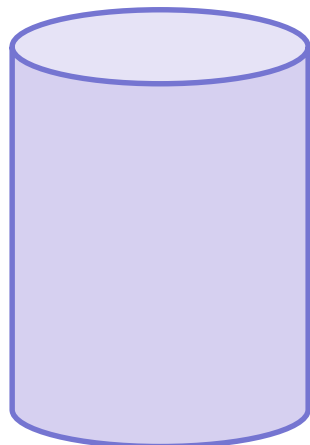
\*技術購入予備費（技術特許購入、ベンチャーへの出資等）および設備拡張資金、有利子負債返済資金など



FY25 実績 中間：129円 期末：376円 年間：505円（過去最高）

※2023年4月1日付けで普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施  
 (FY22以前の配当推移は当該株式分割が行われたと仮定して記載)

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{年度末現預金} \\ \hline 2,185 \text{ 億円} \ast \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \text{必要資金} \\ \hline 1,561 \text{ 億円} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{余剰資金} \\ \hline 624 \text{ 億円} \\ \hline \end{array}$$



208 億円

追加配当

## 必要資金の内訳

①	<b>運転資金</b> <small>前期連結売上高 ÷ 12ヶ月 × 2ヶ月</small>	728 億円
	<b>技術購入予備費(M&amp;A含む)</b> <small>連結売上高 過去3年平均 × 10%</small>	320 億円
	<b>長期有利子負債返済資金</b>	-
	<b>税金・配当等</b>	349 億円
②	<b>設備拡張資金</b> <small>広島新工場等</small>	164 億円

※ 契約負債（前受金）金額などを考慮

(単位：億円)

今回予想

	FY25 1Q	2Q	3Q	4Q	FY26 1Q
売上高	899	1,046	1,093	1,331	1,061
営業利益	345	444	473	588	420
経常利益	340	455	470	585	423
純利益	238	321	367	429	295
営業利益率	38.4%	42.4%	43.3%	44.2%	39.6%
経常利益率	37.8%	43.5%	43.0%	44.0%	39.9%
純利益率	26.5%	30.7%	33.6%	32.2%	27.8%
出荷額	1,111	963	1,136	1,216	1,320

※億円未満 四捨五入

想定為替レート 1Q (4-6月期)  
為替感応度 (年換算)

US\$ : 157円  
US\$ : 約17億円

Euro : 181円  
Euro : 約1億円

出荷額ベース

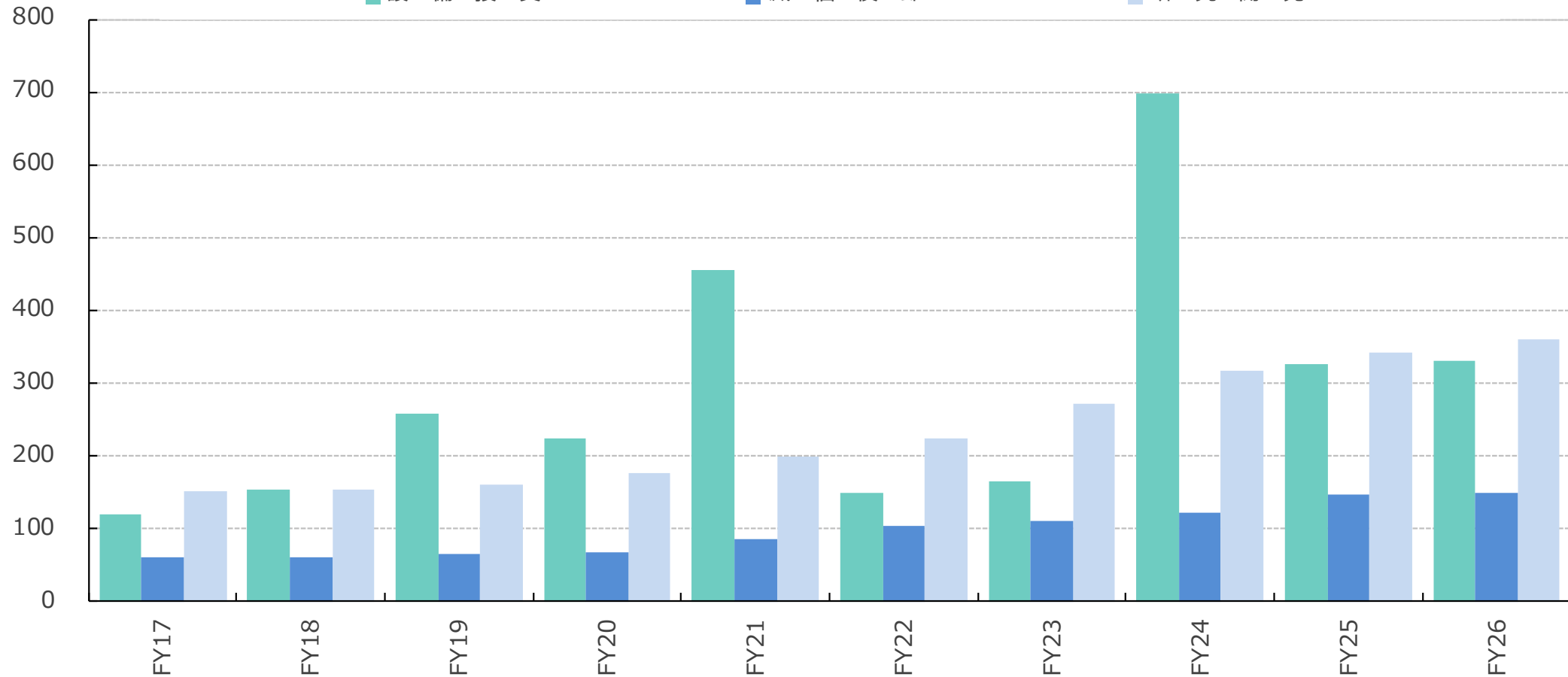
製品群		見通し FY26_1Q 増減率 (QoQ)
	ブレードダイサ	15%
	レーザソー	15%
	<b>ダイサ</b>	<b>15%</b>
	<b>グラインダ</b>	<b>25%</b>
	<b>周辺装置</b>	<b>15%</b>
<b>精密加工装置</b>		<b>20%</b>
<b>精密加工ツール</b>		<b>0%</b>
<b>その他</b>		<b>-20%</b>

(単位：億円)

■ 設備投資

■ 減価償却

■ 研究開発



FY26見通し

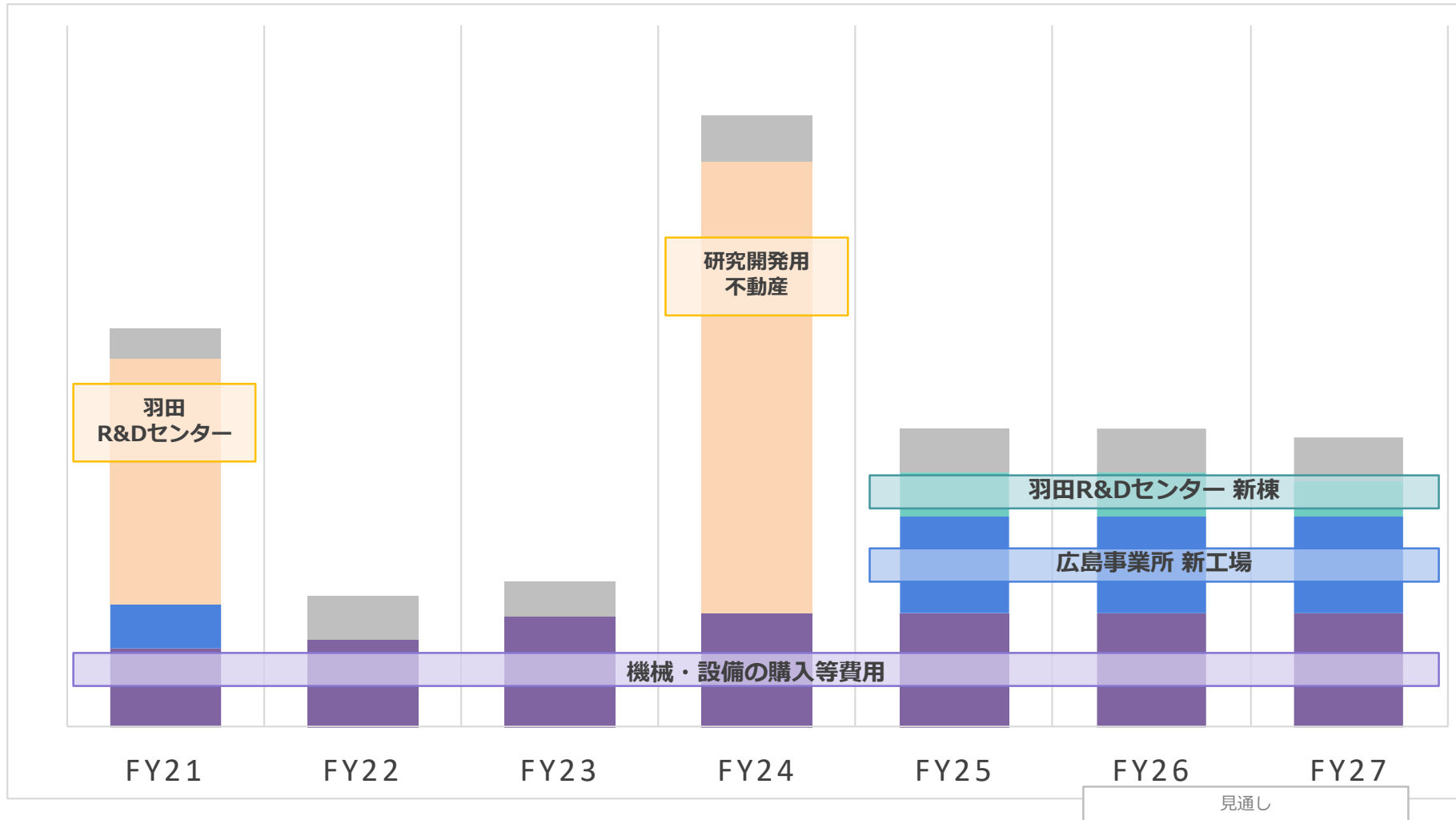
設備投資：約330億円

減価償却：約150億円

研究開発：約360億円

合理化投資、羽田R&Dセンター建替、新工場建築を含む

積極的な研究開発活動を継続

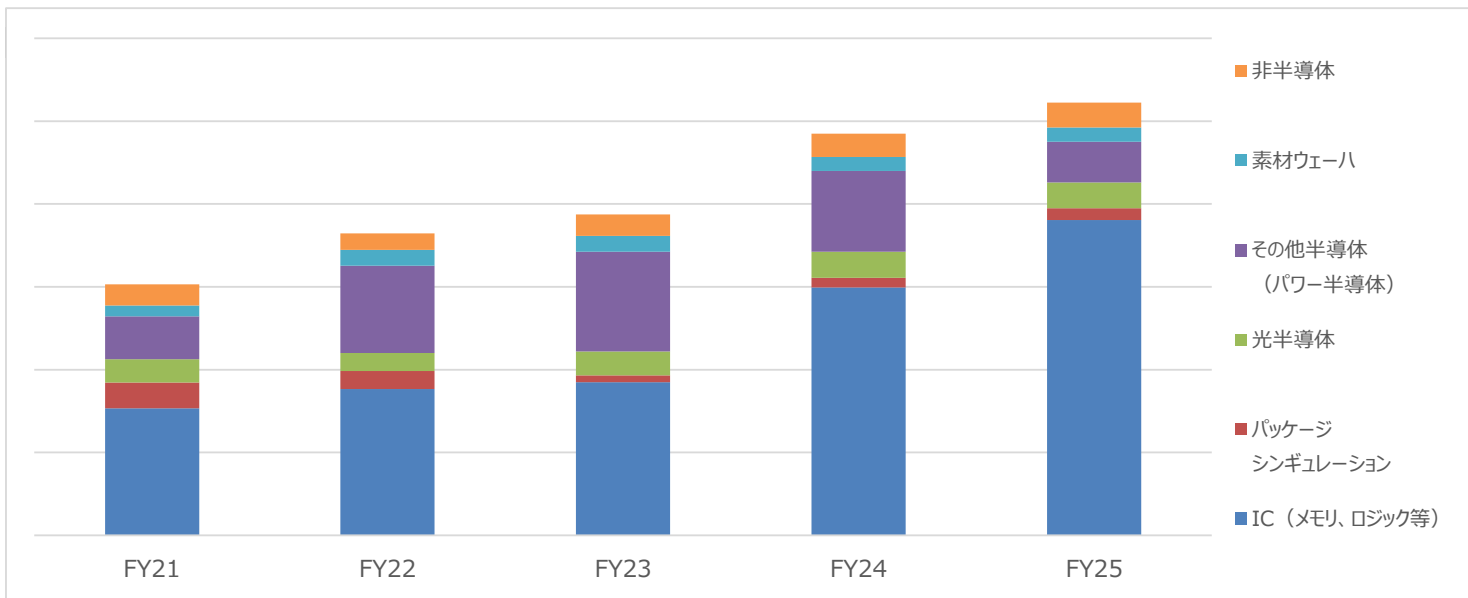


研究開発用不動産	約500億円	支出時期：FY24
羽田R&Dセンター 新棟	約140億円	支出時期：FY25～FY27
広島事業所 新工場	約330億円	支出時期：FY25～FY27

## ■ 出荷動向：生成A I 向け装置出荷が伸長

半導体パッケージ技術の複雑化・高度化が追い風

高付加価値製品がメモリ・ロジック向けの出荷額を押し上げ



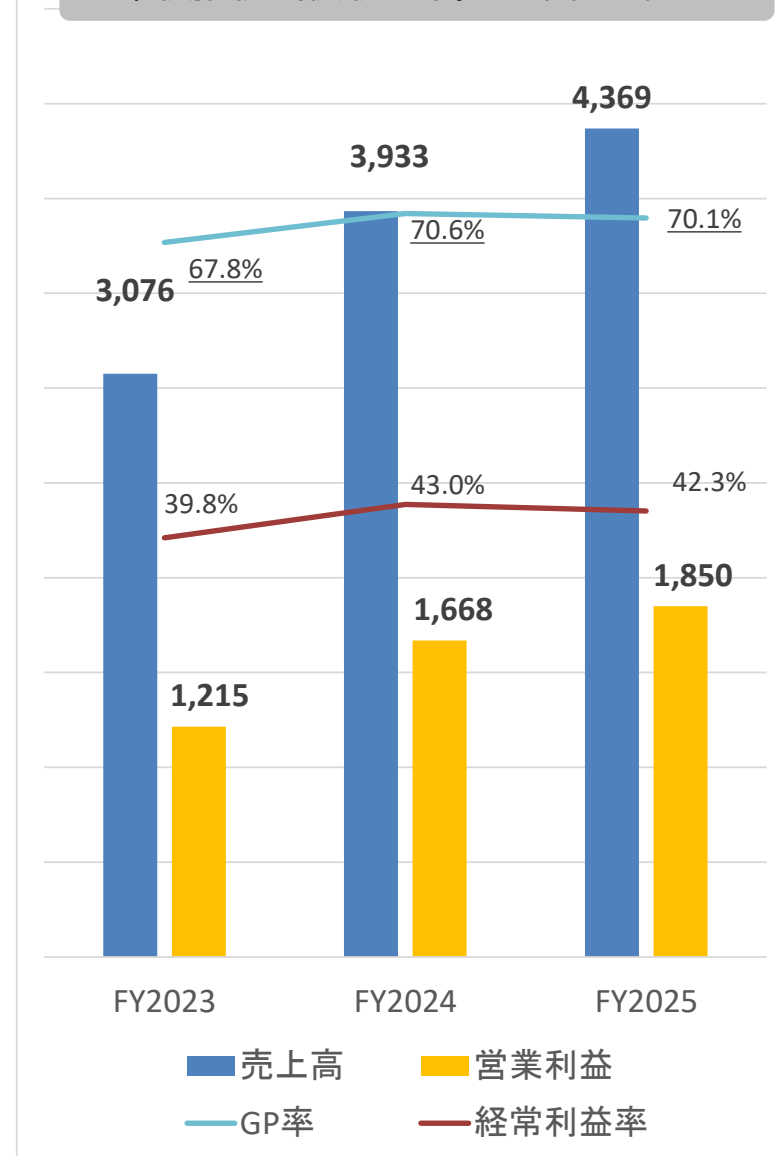
## ■ 業績：6期連続最高益を更新、収益性は高水準

GP率70%超、経常利益率40%超を2期連続で記録

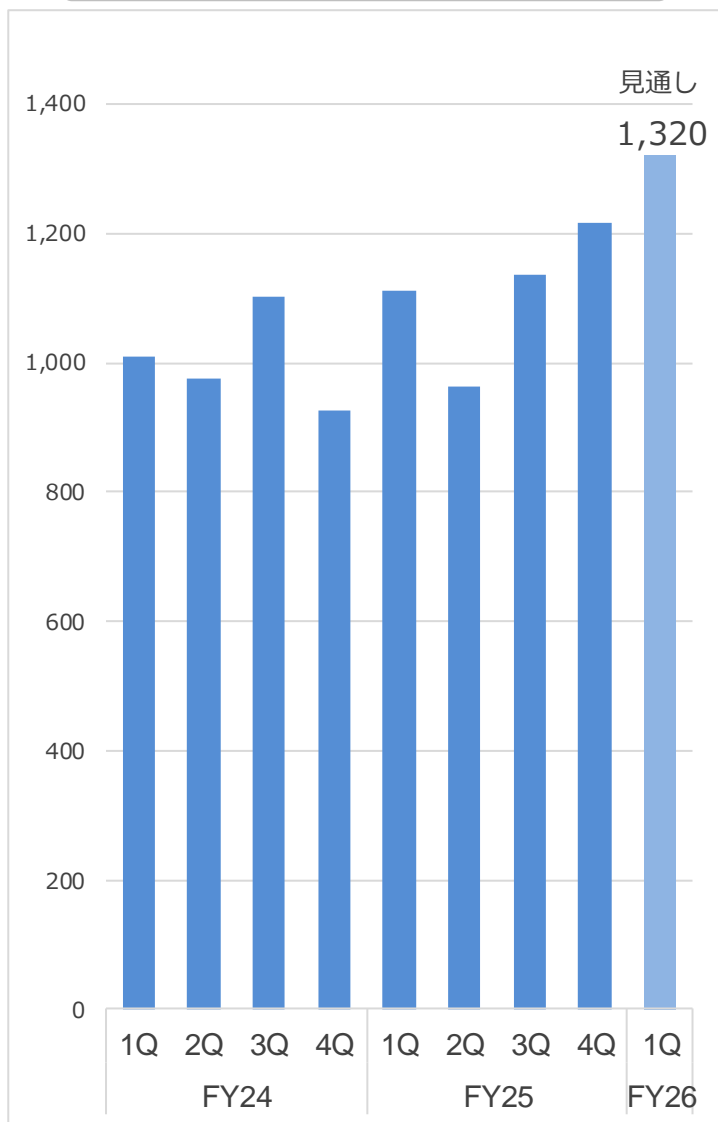
技術、内製化、生産効率化など各種改善が収益力強化に寄与

## ■ 最高益および余剰資金より年間配当505円（過去最高）

業績推移（検収基準） 単位：億円



出荷額 四半期推移 単位：億円



- **生成A I 関連を中心に設備投資意欲は引き続き堅調**  
高付加価値製品の出荷が継続する見通し  
A I 以外の用途の需要動向も注視
- **先端パッケージ技術は用途拡大および本格立ち上がり**に期待
- **国際情勢が事業環境に与える影響を注視**  
調達・コスト動向を注視しつつ、BCM強化の取り組みを継続
- **量の質を高め、会社を強くする投資を継続**  
技術開発力の強化および供給責任を果たすための生産能力向上へ  
Fab Important戦略のもと、積極的な設備投資を継続  
(羽田R&Dセンター新棟、広島事業所郷原工場、他)
- **良質な企業文化は会社を強くする源泉**  
DISCO VALUES、Will会計、PIM活動など、  
「会社を強くする」取り組みに引き続き注力

# 参考 通期推移 グラフ集

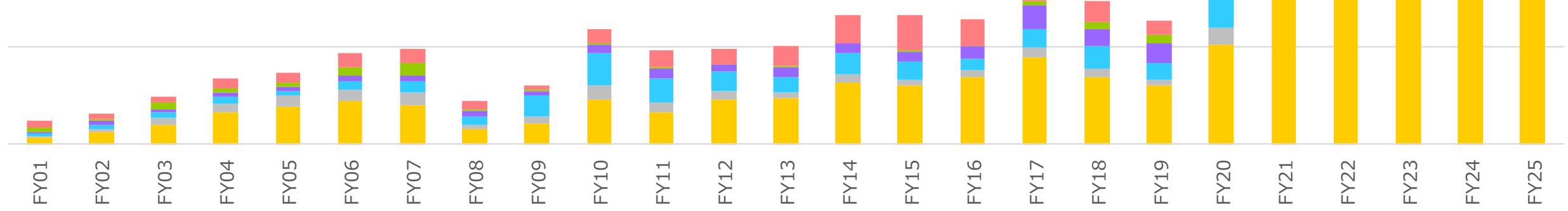
# 精密加工装置 用途別売上高

出荷額ベース

通期

精密加工装置

- 非半導体
- 素材ウェーハ
- その他半導体
- 光半導体
- パッケージ  
シンギュレーション
- IC

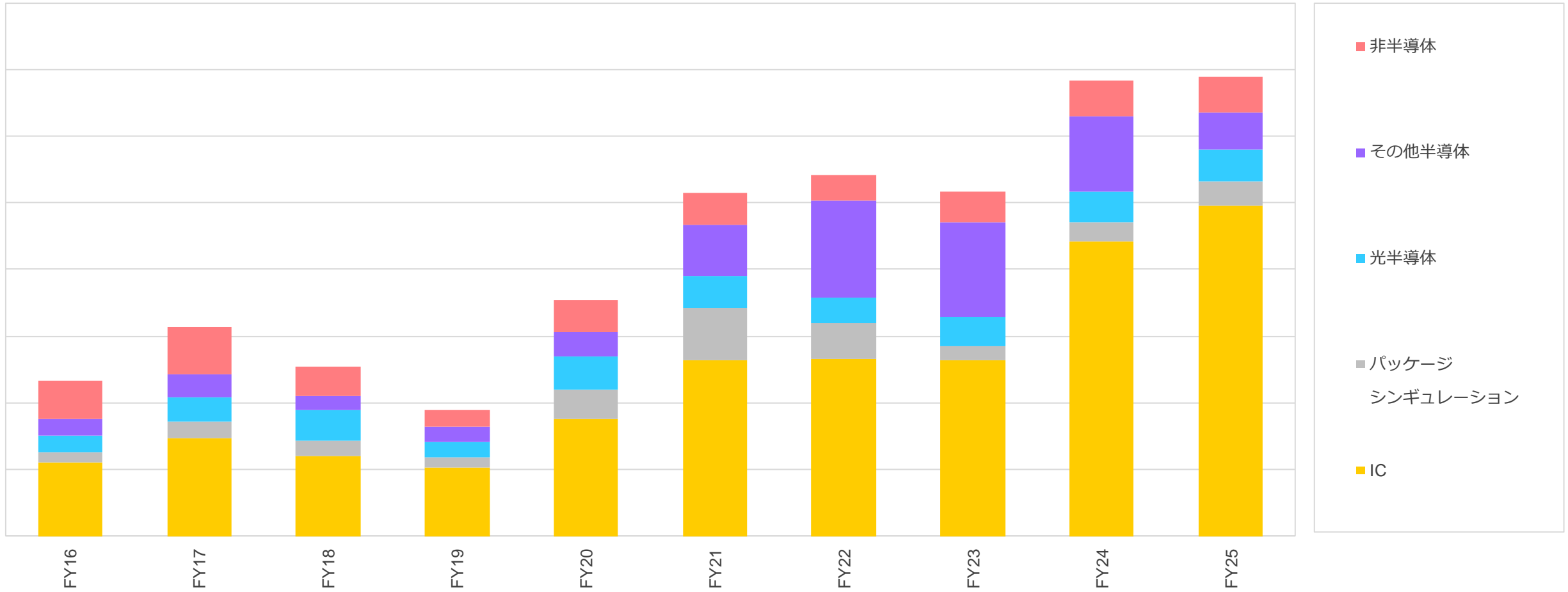


# ダイサ用途別売上高

出荷額ベース

通期

ダイサ



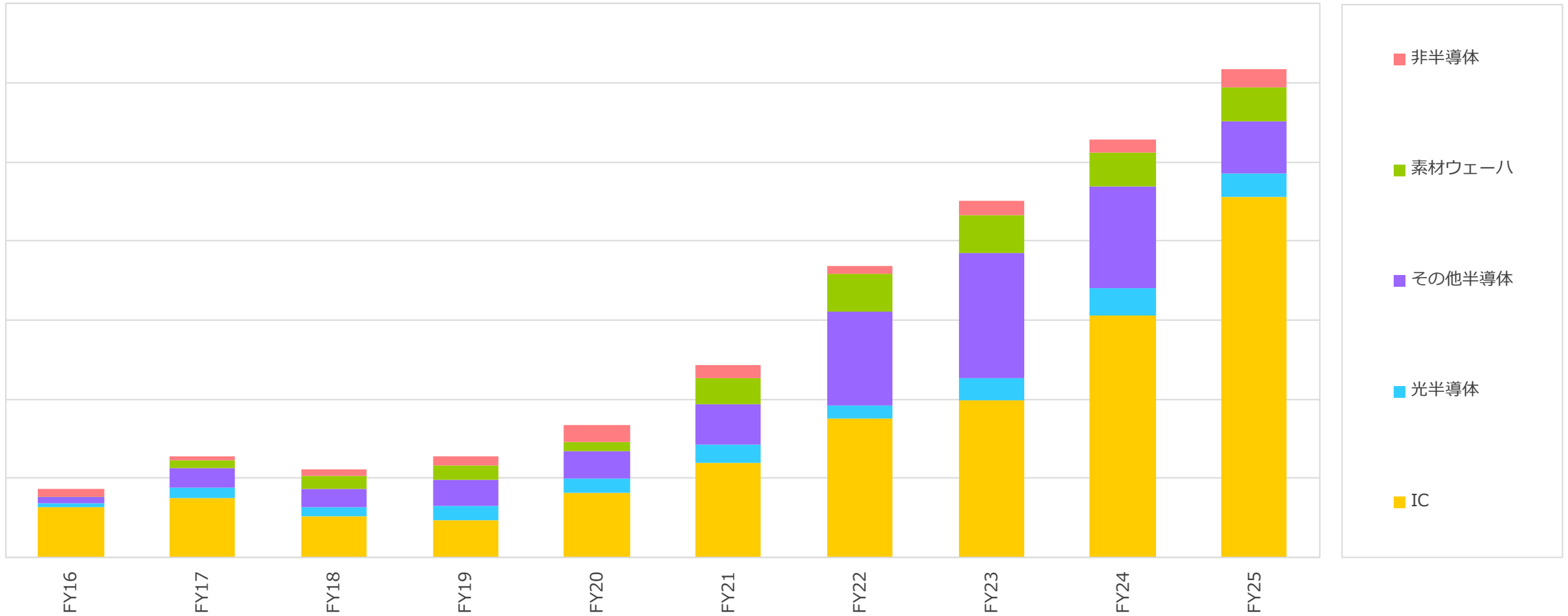
- 非半導体
- その他半導体
- 光半導体
- パッケージ  
シングレーション
- IC

# グラインダ用途別売上高

出荷額ベース

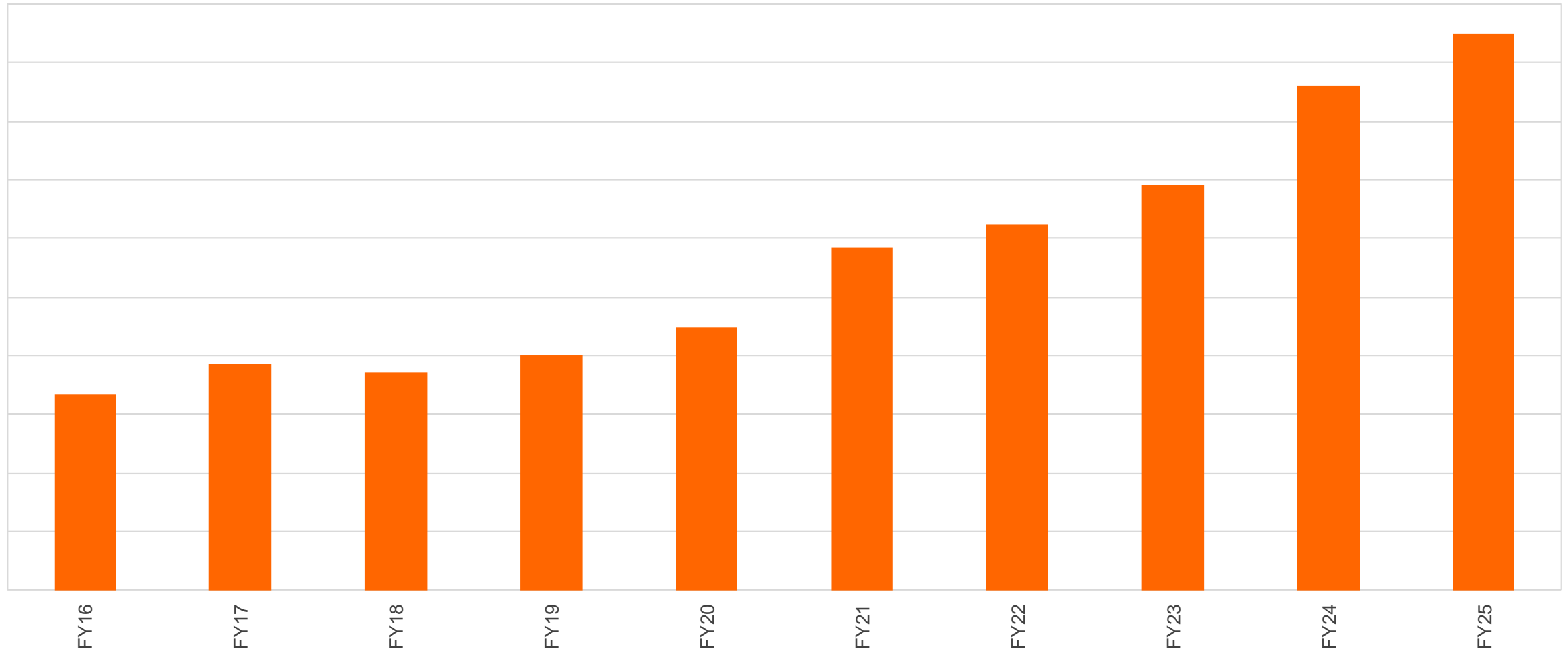
通期

グラインダ



出荷額ベース

通期



# 【参考】製品群別 用途別 データ集

出荷額ベース

■ 製品群	4Q			Full Year	
	構成比	QoQ	YoY	構成比	YoY
精密加工装置合計	62%	9%	28%	62%	7%
内、ダイサ	32%	23%	29%	31%	1%
ブレードダイサ	16%	28%	36%	16%	3%
レーザー	16%	18%	22%	15%	-1%
内、グラインダ	25%	-9%	26%	28%	17%
内、周辺装置	4%	69%	44%	3%	-2%
精密加工ツール	21%	2%	31%	21%	9%
その他	17%	7%	46%	16%	26%
出荷額合計	100%	7%	31%	100%	10%

出荷額ベース

		FY24				FY25			
製品	用途	24-1Q	24-2Q	24-3Q	24-4Q	25-1Q	25-2Q	25-3Q	25-4Q
ダイサ	1_IC	67%	69%	60%	62%	78%	78%	64%	69%
	2_パッケージ・シンギュレーション	4%	3%	6%	4%	5%	4%	8%	4%
	3_光半導体	5%	5%	10%	7%	5%	9%	6%	9%
	4_その他_半導体	19%	16%	18%	13%	7%	5%	11%	9%
	5_非半導体	5%	7%	7%	14%	6%	4%	11%	9%
<b>ダイサ</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
グライнда	1_IC	60%	61%	62%	48%	80%	71%	68%	76%
	2_光半導体	6%	1%	8%	11%	5%	6%	1%	8%
	3_その他_半導体	27%	31%	19%	22%	9%	11%	15%	7%
	4_素材ウエーハ	6%	4%	9%	14%	4%	8%	10%	6%
	5_非半導体	2%	3%	3%	6%	2%	4%	6%	3%
<b>グライнда</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

出荷額ベース

		FY24				FY25			
製品	用途	24-1Q	24-2Q	24-3Q	24-4Q	25-1Q	25-2Q	25-3Q	25-4Q
ダイサ	1_IC	210%	135%	50%	-8%	23%	-7%	-7%	44%
	2_パッケージ・シンギュレーション	23%	-15%	270%	7%	33%	14%	24%	22%
	3_光半導体	-26%	-46%	112%	26%	-5%	50%	-47%	64%
	4_その他_半導体	-3%	-33%	15%	-48%	-58%	-72%	-45%	-13%
	5_非半導体	-17%	-13%	26%	65%	34%	-54%	55%	-17%
<b>ダイサ</b>		<b>75%</b>	<b>36%</b>	<b>49%</b>	<b>-10%</b>	<b>7%</b>	<b>-17%</b>	<b>-12%</b>	<b>29%</b>
グライнда	1_IC	160%	68%	73%	-14%	66%	18%	28%	101%
	2_光半導体	46%	-86%	-15%	819%	-1%	652%	-84%	-14%
	3_その他_半導体	-16%	-4%	-15%	-37%	-59%	-63%	-5%	-61%
	4_素材ウエーハ	-45%	-62%	79%	26%	-8%	104%	28%	-42%
	5_非半導体	-50%	-24%	19%	31%	46%	29%	125%	-34%
<b>グライнда</b>		<b>37%</b>	<b>11%</b>	<b>34%</b>	<b>-6%</b>	<b>24%</b>	<b>2%</b>	<b>16%</b>	<b>26%</b>

出荷額ベース

		FY24				FY25			
製品	用途	24-1Q	24-2Q	24-3Q	24-4Q	25-1Q	25-2Q	25-3Q	25-4Q
ダイサ	1_IC	20%	-4%	-7%	-14%	62%	-28%	-7%	33%
	2_パッケージ・シンギュレーション	14%	-34%	119%	-35%	43%	-44%	138%	-36%
	3_光半導体	10%	-12%	115%	-40%	-16%	40%	-23%	83%
	4_その他_半導体	-11%	-22%	19%	-37%	-28%	-48%	134%	0%
	5_非半導体	-34%	46%	-3%	77%	-47%	-50%	227%	-5%
<b>ダイサ</b>		<b>8%</b>	<b>-7%</b>	<b>7%</b>	<b>-16%</b>	<b>29%</b>	<b>-29%</b>	<b>14%</b>	<b>23%</b>
グラインダ	1_IC	14%	-2%	18%	-35%	120%	-30%	28%	2%
	2_光半導体	402%	-85%	952%	20%	-46%	10%	-78%	547%
	3_その他_半導体	-17%	10%	-29%	-3%	-46%	-1%	80%	-60%
	4_素材ウエーハ	-45%	-29%	148%	29%	-59%	56%	56%	-41%
	5_非半導体	-59%	62%	24%	61%	-55%	44%	115%	-53%
<b>グラインダ</b>		<b>-1%</b>	<b>-4%</b>	<b>17%</b>	<b>-16%</b>	<b>31%</b>	<b>-20%</b>	<b>32%</b>	<b>-9%</b>

検収ベース

■ 構成比	FY2024				FY2025			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
日本	9%	11%	12%	10%	10%	10%	9%	12%
アメリカ	15%	10%	8%	15%	9%	8%	6%	9%
アジア	69%	72%	74%	66%	75%	75%	79%	73%
シンガポール	6%	8%	8%	7%	7%	7%	10%	9%
台湾	16%	17%	19%	22%	27%	28%	28%	26%
韓国	14%	12%	9%	9%	9%	10%	6%	6%
中国 ※	32%	33%	37%	27%	30%	28%	34%	31%
その他	1%	1%	1%	2%	3%	2%	1%	1%
ヨーロッパ	7%	7%	5%	9%	6%	7%	6%	6%
合計	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

※外資メーカー現地工場向け含む

**当社ではMissionの実現性の向上に取り組むことで、  
結果として企業価値の向上と競争力向上に繋がり、  
資本市場の皆さまの期待に応えることができると考えています**

- ✓ 事業の質の追求
- ✓ 自己資金の活用と目的
- ✓ 株主還元方針
- ✓ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

上記の考え方について[詳しくはこちら](#)をご確認ください

### 本資料について

掲載内容に関しては細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や第三者によるデータの改ざん等に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。また、本資料は投資勧誘を目的にしたものではありません。投資はご自身の判断において行われるようお願いいたします。

### 表記について

年間の会計期間である4月～翌年3月までをFY（Fiscal Year）と表記し、四半期の会計期間は4-6月を1Q、7-9月を2Q、10-12月を3Q、1-3月を4Qと表記しています。

金額単位に応じて、単位未満の金額を四捨五入または切り捨て処理しており合計値が合わない場合があります。

%は実際の金額を基に算出しています。

### 将来の見通しに関する注意事項

この資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。実際の業績はさまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。実際の業績に影響を与えうる重要な要素には世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

英語圏の方々のために英語資料を提供する場合、和文（原文）と英訳の内容が相違した際は和文の内容が優先されます。

本資料の著作権は当社に帰属しており、無断での転載は禁じられています。私的使用その他法律によって明示的に認められる範囲を超えて、本資料を使用（複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む）するためには、当社の事前の明示の許諾が必要です。

<https://www.disco.co.jp/>